

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Старший инженер 512 ВП МО РФ

А.Р. Чириченко

« 13 »

2019г.

Заместитель директора
по инновационной деятельности
НПК «Технологический центр»

В.Г. Сницар

« 13 »

11

2019г.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

5529TP074, 5529TP074A

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ

ГАВЛ.431268.018Д1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1491				

Главный конструктор изделия

А.Н. Денисов

« 13 »

11

2019г.

НАЗНАЧЕНИЕ, СХЕМО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Микросхемы интегральные 5529TP074, 5529TP074A представляют собой многофункциональные цифровые матрицы, выполненные по полупроводниковой технологии на МОП-транзисторах.

Микросхемы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. Количество элементов в схеме электрической (количество эквивалентных вентилей), не менее - 5260000 (1315000).

Конструктивное исполнение для микросхемы 5529TP074 в корпусе МК 4250.208-2 приведено на рисунке 1, для микросхемы 5529TP074A в корпусе МК 4249.176-2 приведено на рисунке 2.

Схема электрическая структурная микросхемы представлена на рисунке 3. Схема электрическая структурная периферийной ячейки приведена на рисунке 4.

Электрические параметры микросхемы приведены в таблице 1. Предельные и предельно-допустимые значения электрических режимов эксплуатации микросхемы приведены в таблице 2.

Таблицы назначения выводов микросхем приведены в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.

Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку):

– микросхема 5529TP074-X¹⁾ – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4250.208-2, карта заказа²⁾;

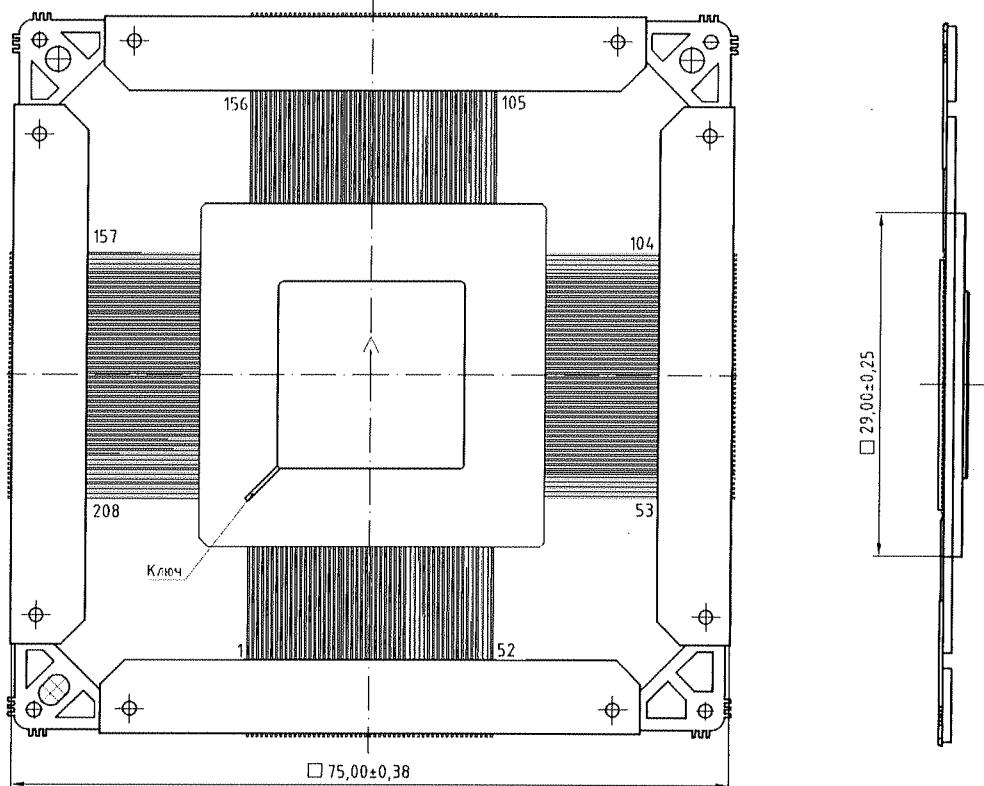
микросхема 5529TP074A-X¹⁾ – АЕНВ.431260.290ТУ, корпус МК 4249.176-2, карта заказа²⁾;

¹⁾ X – Регистрационные номера карт заказа (цифровые или буквенно-цифровые коды), указанные в обозначении полузаизных микросхем на основе БК в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

²⁾ Децимальные номера карт заказа в соответствии с АЕНВ.431260.290ТУ.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	ГАВЛ.431268.018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Астахова	<i>А.А.</i>	<i>13.11.19</i>				
Пров.	Тикашкин	<i>В.Н.</i>	<i>13.11.19</i>				
Н. контр.	Казаков	<i>А.А.</i>	<i>10.11.19</i>				
Утв.	Денисов	<i>А.А.</i>	<i>13.11.19</i>				
ГАВЛ.431268.018Д1							
Микросхемы интегральные 5529TP074 , 5529TP074A Справочный лист					Лит.	Лист	Листов
					A	2	29

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 1 – Микросхема интегральная 5529TP074

Корпус МК 4250.208-2

Металлокерамический

Материал покрытия выводов: золото

Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.018ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 16,0 г.

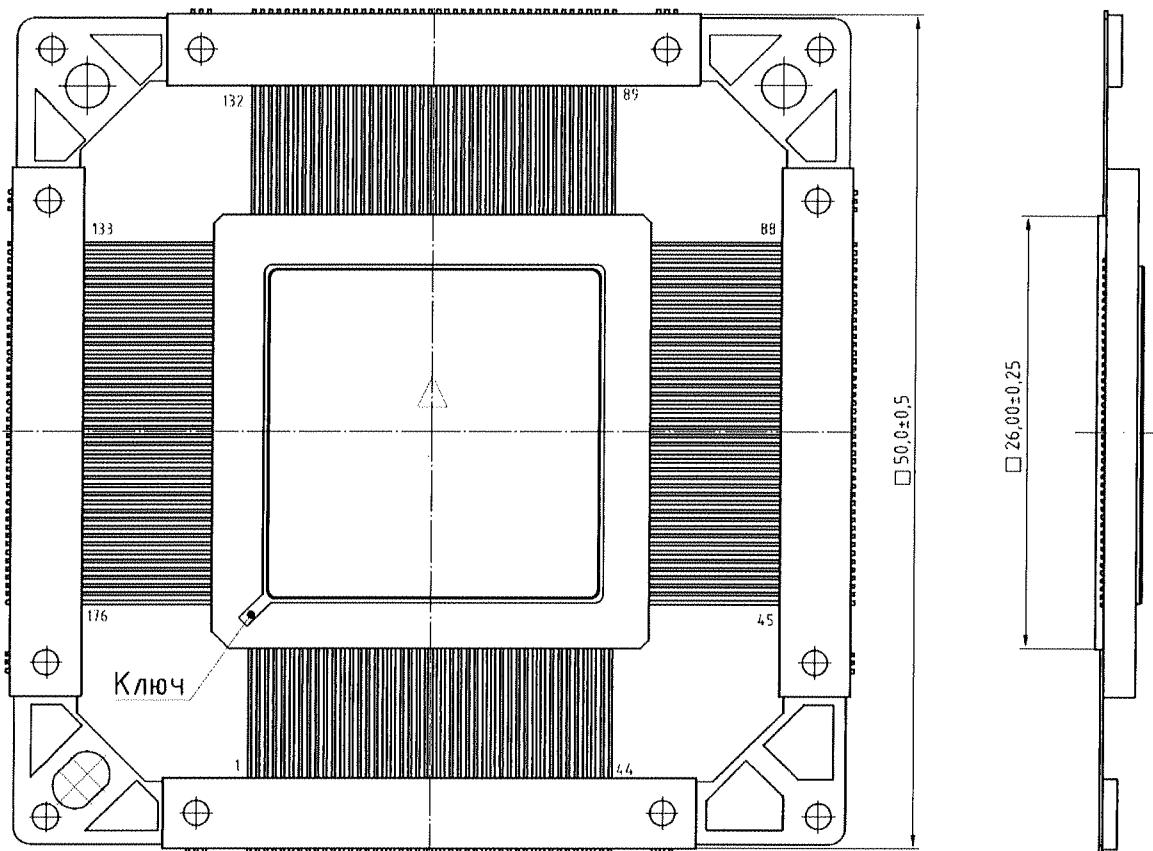
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
14/91	Дж. Б. О. д. с. 10.02.00			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

3



Знак чувствительности микросхем к СЭ обозначен равносторонним треугольником (Δ). Первый вывод микросхемы находится в левом нижнем углу корпуса. Левый нижний угол определяется по фаске на корпусе. Первым выводом является левый нижний вывод корпуса. Нумерация выводов – против часовой стрелки.

Нумерация выводов показана условно.

Рисунок 2 – Микросхема интегральная 5529TP074А

Корпус МК 4249.176-2

Металлокерамический

Материал покрытия выводов: золото

Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.018-01ЭТ.

Масса микросхемы не должна превышать 8,0 г.

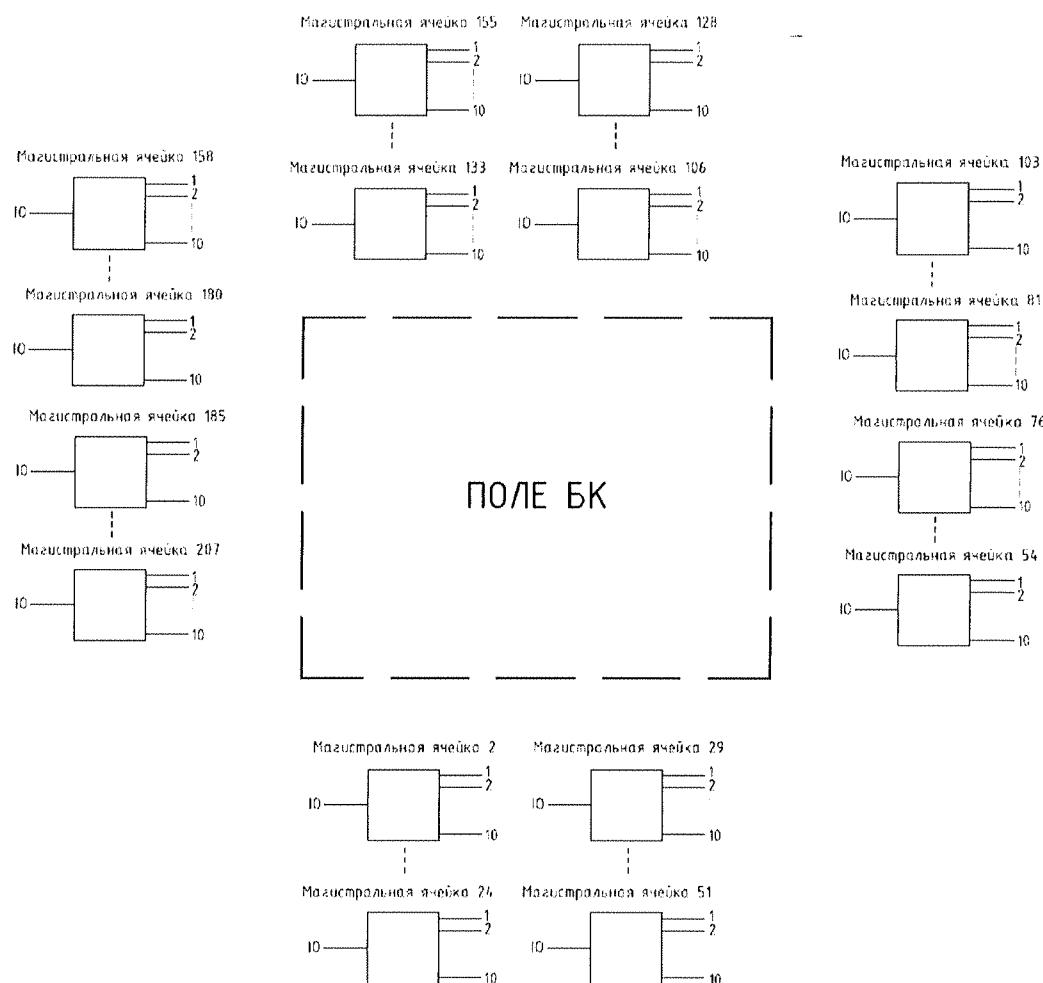
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
ГАВЛ.431268.018Д1	27.07.2018			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



1. Нумерация выводов ячеек приведена условно. Обозначения выводов приведены в соответствующей регистрационному номеру карте заказа.
2. Нумерация ячеек поля соответствует номеру столбца ячеек в поле микросхемы и порядковому номеру в столбце.
3. Магистральные ячейки 1, 26, 27, 52, 78, 79, 105, 130, 131, 156, 182, 183 (на схеме не показаны) соответствует контакту «Земля».
4. Магистральные ячейки 25, 28, 53, 77, 80, 104, 129, 132, 157, 181, 184, 208 (на схеме не показаны) соответствует контакту «Питание»

Рисунок 3 - Схема электрическая структурная микросхемы 5529TP074,
5529TP074A

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1431	Лебедев Ю.Ю.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.018Д1	Лист

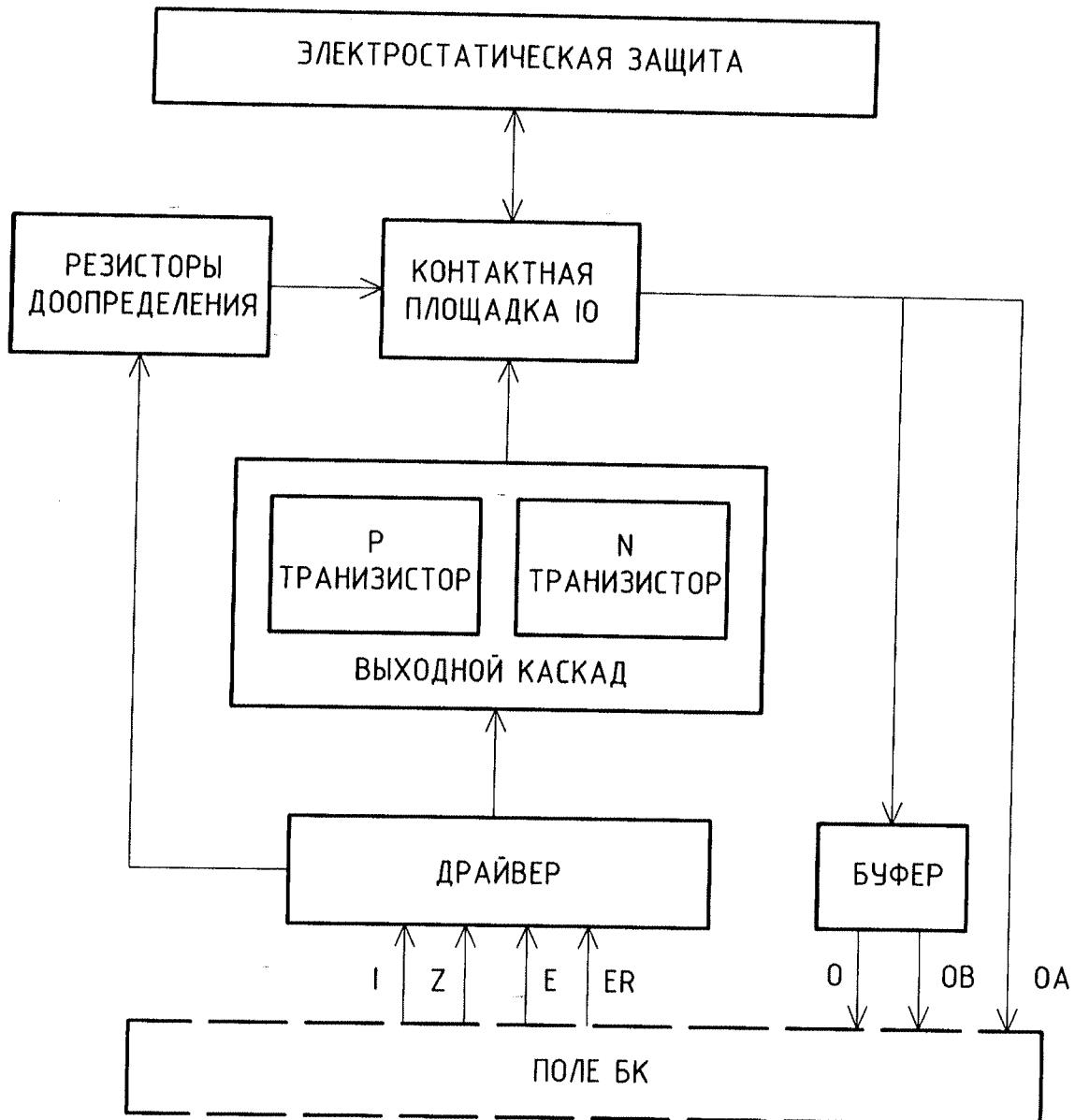


Рисунок 4 – Схема электрическая структурная периферийной ячейки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
<i>Ильин А. В.</i>	<i>12.01.2018</i>			

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механические факторы

1 Синусоидальная вибрация

Диапазон частот, Гц 1 – 5000

Амплитуда ускорения, м/с² (g) 400 (40)

2 Удары одиночного действия в любом направлении

Амплитуда пикового ударного ускорения, м/с² (g) 15000 (1500)

Длительность действия ударного ускорения, мс 0,1 – 2,0

3 Удары многократного действия в любом направлении

Амплитуда пикового ударного ускорения, мс (g) 1500 (150)

Длительность действия ударного ускорения, мс 1–5

4 Линейное ускорение в любом направлении

Амплитуда линейного ускорения, м/с² (g) 5000 (500)

5 Акустический шум

Диапазон частот, Гц 50 – 10000

Уровень звукового давления

(относительно 0,00002 Па), дБ 170

Климатические факторы

1 Атмосферное пониженное рабочее давление, Па

(мм рт. ст.) $1,3 \times 10^{-4} (10^{-6})$

2 Повышенное рабочее давление, кПа(мм рт. ст.)

294(2205)

3 Повышенная температура среды:

рабочая, °C +85

предельная, °C +125

4 Пониженная температура среды:

рабочая, °C минус 60

предельная, °C минус 60

5 Смена температур:

от пониженной предельной

минус 60

температуры среды, °C

до повышенной предельной

температуры среды, °C

минус 60

+125

6 Повышенная относительная

влажность при 35°C, % 98*

Вид исполнения по ГОСТ РВ 20.39.414.1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17.01	17.01.2021			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	7
					ГАВЛ.431268.018Д1	

7 Атмосферные конденсированные осадки (роса, иней)	*
8 Соляной (морской) туман	*
9 Плесневые грибы	
10 Статическая пыль	**
11 Контрольные среды (среды заполнения), объемная доля компонентов контрольной среды, %	
гелиево-воздушная	90
аргоно- воздушная	90
аргоно- азотная	90

*Соответствие микросхем данному требованию обеспечивается при условии их многослойного лакового покрытия в составе аппаратуры.

**Требования по устойчивости к воздействию статической пыли не предъявляются.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1321	Д.А.Л.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения питания U_{CC} микросхем должно быть от 2,70 В до 3,63 В.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Т а б л и ц а 1 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температу- ра среды, °C
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение низкого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OL} от 1 до 12,0 мА	U_{OL}	-	0,3	+25±10 -60 +85
2 Выходное напряжение высокого уровня, В при $U_{CC}=2,7$ В, I_{OH} от 1 до 12,0 мА	U_{OH}	$U_{CC}-0,3$	-	+25±10 -60 +85
3 Ток потребления статический, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{CC}	-	10,0 ²⁾ 30,0 ²⁾	+25±10 -60 +85
4 Токи утечки низкого и высокого уровней на выходе, мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{ILL}, I_{ILH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
5 Выходной ток низкого и высокого уровней в состоянии «Выключено» на выводах выход (вход/выход), мкА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OZH}(U_{IOZH})=U_{CC}$, $U_{OZL}(U_{IOZL})=0$ В	I_{OZL}, I_{OZH}	-1,0 -3,0	1,0 3,0	+25±10 -60 +85
6 Ток доопределения внешнего вывода до низкого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RL}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85
7 Ток доопределения внешнего вывода до высокого уровня, мА при $U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=U_{CC}$, $U_{IL}=0$ В	I_{RH}	0,005	2,0	+25±10 -60 +85

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1221	2022-02-26			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	9
ГАВЛ.431268.018Д1						

Окончание таблицы 1

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температу- ра среды, °C
		не менее	не более	
8 Время задержки на вентиль ³⁾ , пс при $U_{CC}=3,63$ В, $C_L \leq 150$ пФ	t_{DB}	-	60,0	+25±10
			100,0	-60 +85
9 Входная ёмкость, пФ	C_I	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
10 Выходная ёмкость, пФ	C_O	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85
11 Ёмкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$	-	7,0	+25±10
			10,0	-60 +85

¹⁾ Погрешность задания температуры составляет ± 3 °C.

²⁾ Значения могут быть уточнены в карте заказа.

³⁾ В карте заказа могут устанавливаться другие динамические параметры с указанием метода контроля.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквен- ное обозна- чение парамет- ра	Предельно- допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
1 Напряжение питания, В	U_{CC}	2,7	3,63	-0,4	4,0
2 Напряжение, прикладываемое к выводу закрытой микросхемы, В	U_{OZ}	0,0	U_{CC}	-0,4	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
3 Входное напряжение низкого уровня, В	U_{IL}	0,0	0,4	-0,4	-
4 Входное напряжение высокого уровня, В	U_{IH}	($U_{CC}-0,4$)	U_{CC}	-	$U_{CC}+0,4$, но не более 4,0
5 Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	-	12,0	-	24,0

Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. № Взам. инв. №				Подп. и дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. № Взам. инв. №				
12.07.2010	12.07.2010					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	10
					ГАВЛ.431268.018Д1	

Окончание таблицы 2

Наименование параметра, обозначение единицы физической величины, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
6 Выходной ток высокого уровня, мА	I _{OH}	-	12,0	-	24,0
7 Емкость нагрузки, пФ	C _L	-	150,0	-	250,0

НАДЕЖНОСТЬ

Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых АЕНВ.431260.290ТУ, должна быть не менее 140 000 ч при температуре окружающей среды не более $(65 + 5)^\circ\text{C}$ и не менее 200 000 ч в облегченном режиме при $U_{CC} = 3,0 \text{ В} \pm 5\%$, выходные токи I_{OL}, I_{OH} не более 50 % от предельно-допустимых значений, установленных в таблице 2.

Гамма – процентный срок сохраняемости ($T_{Cs\gamma}$) микросхем при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, должен быть – 25 лет. Требования к показателям безотказности действуют в пределах срока службы T_{сл}, устанавливаемого численно равным $T_{Cs\gamma}$.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
<i>Ильин</i>	<i>Дат. 25.01.20</i>			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					11

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы должен быть следующим:

- при включении на микросхемы сначала подается напряжение питания U_{CC} , а затем входные напряжения U_I , или одновременно;
- при выключении напряжение питания U_{CC} снимается последним или одновременно с входными напряжениями U_I .

Допускается работа микросхем при ёмкости нагрузки C_L до 250 пФ. При этом динамические параметры не гарантируются.

Неиспользуемые выводы микросхем допускается подключать к шине общего вывода GND (0 В) или к шине напряжения питания U_{CC} .

Допустимое значение потенциала СЭ – не более 2000 В при использовании стандартных периферийных ячеек и не более 1000 В при использовании периферийных ячеек без верхнего защитного диода, что указывается в карте заказа.

Нумерацию, обозначение, наименование выводов, дополнительные указания к этапу разработки аппаратуры приводят в картах заказа.

Рекомендуется установку и крепление микросхем на платы проводить в соответствии с рисунком 5. Вид формовки микросхем - в соответствии с рисунком 6.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по ОСТ 11 073.063 при установке их на некерамические платы. Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов микросхемы – не более двух.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Рекомендуется начинать пайку с выводов V_{CC} и GND (0 В). Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

В непосредственной близости между выводами U_{CC} и выводами GND (0 В), указанными в картах заказа, должны быть подключены керамические конденсаторы емкостью не менее 0,3 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 В. Необходимое количество и номиналы конденсаторов определяются разработчиком аппаратуры.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Инв. № подп.	Документ				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.018Д1
1	1				12

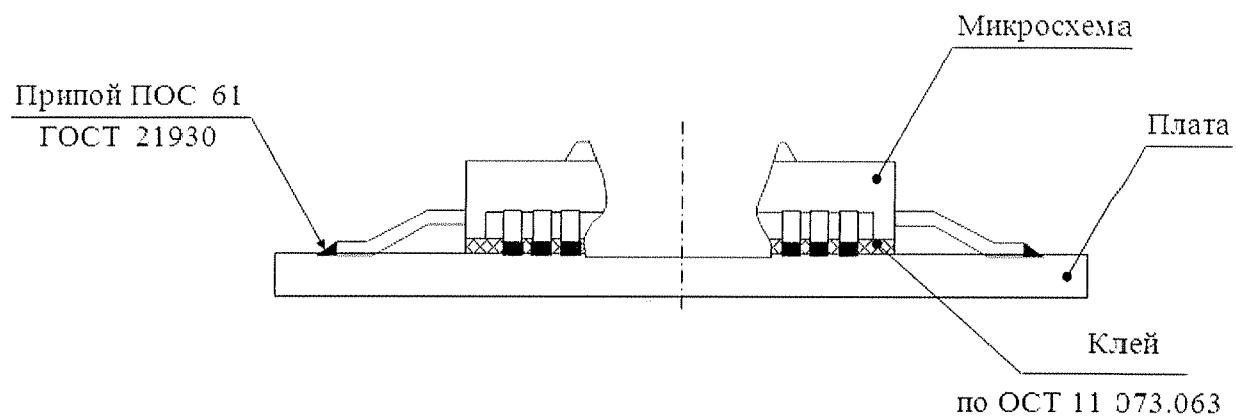


Рисунок 5 – Пример установки и крепления микросхем 5529TP074, 5529TP074A на плате

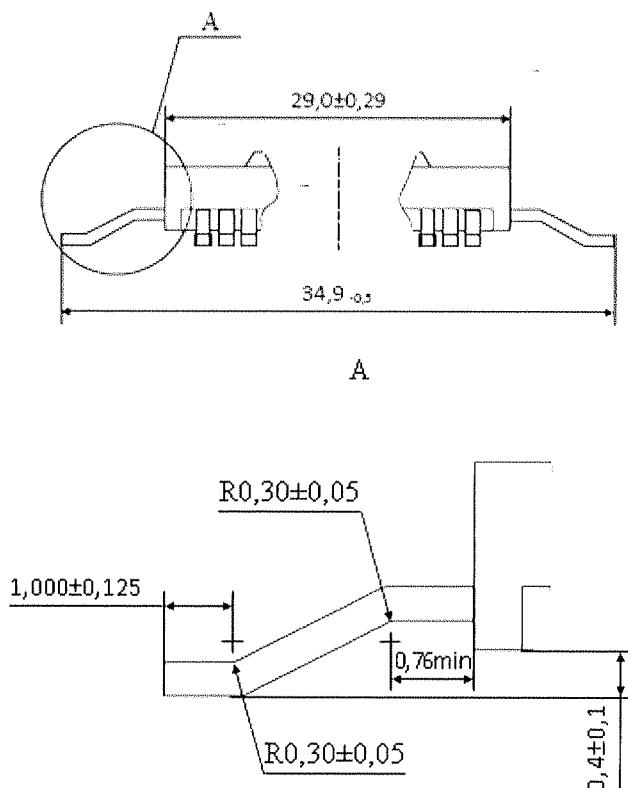


Рисунок 6 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем 5529TP074

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
12291	Адм. Уд. О.д.			

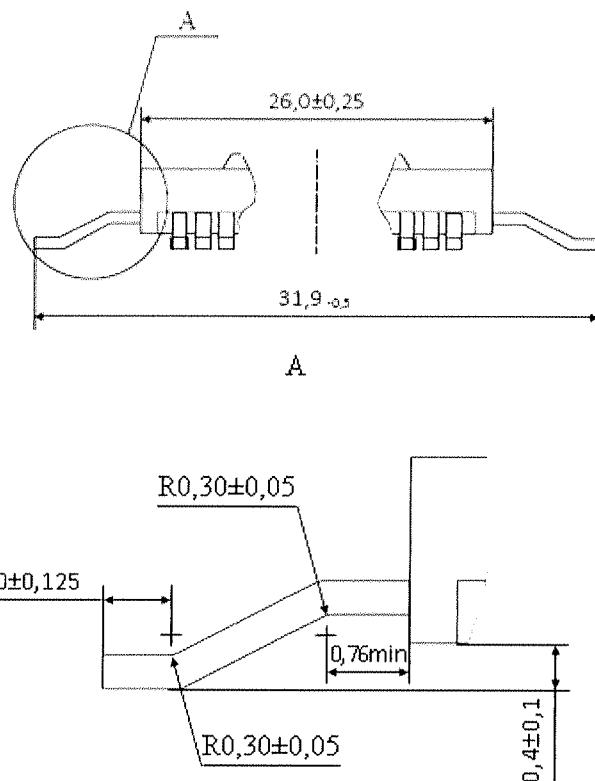


Рисунок 7 – Рекомендуемый вид формовки и обрезки выводов микросхем

5529TP074A

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1229	Дж. А. А.			

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

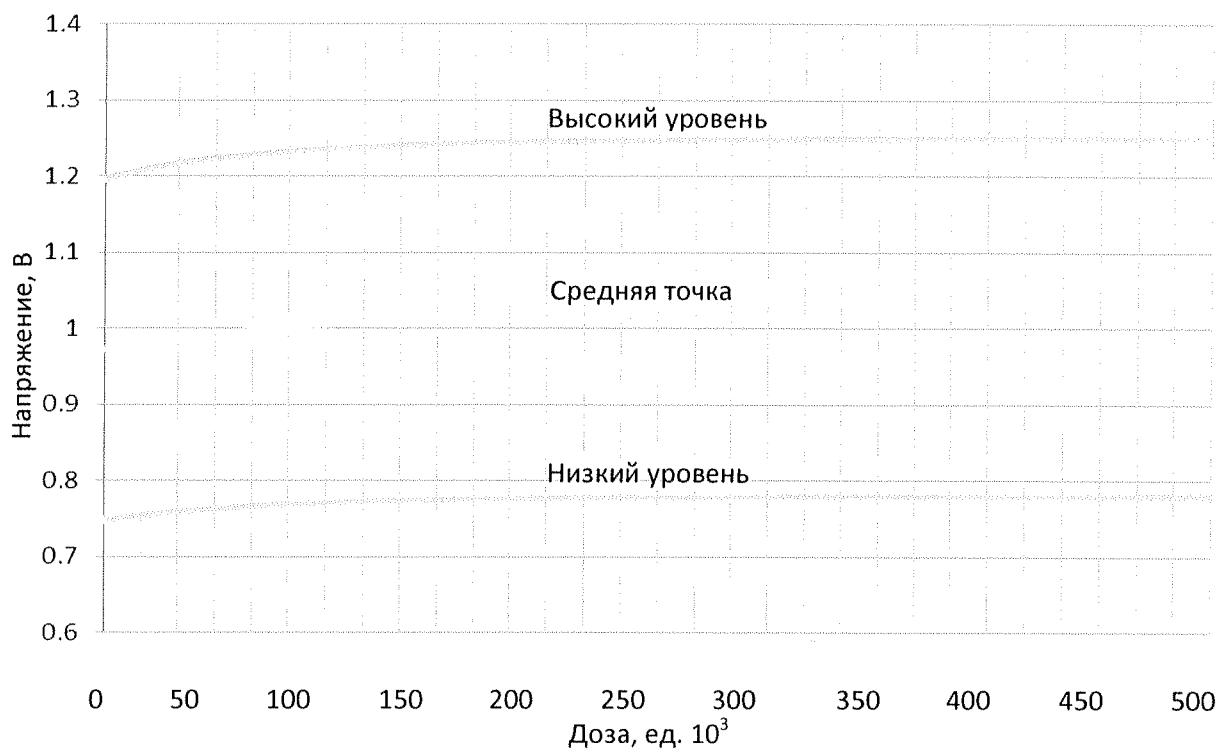


Рисунок 8 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ИЧ-91	Д.А. С. О. Р. О.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист
15

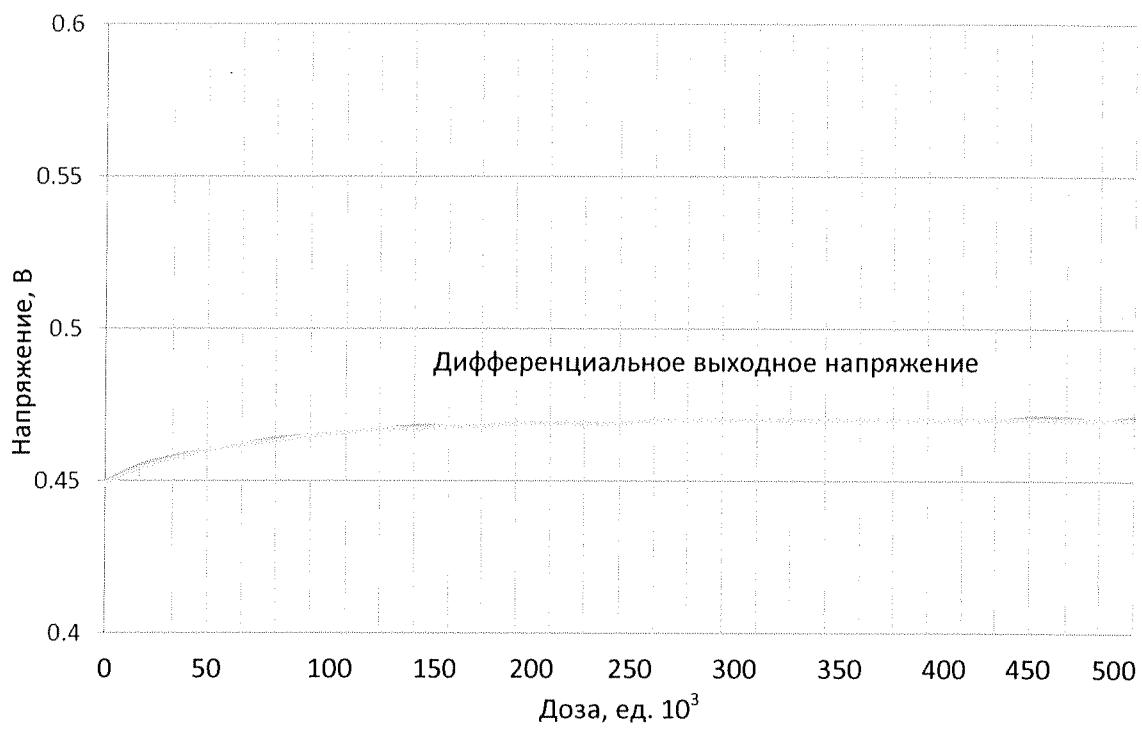


Рисунок 9 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1361	27.07.20			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

16

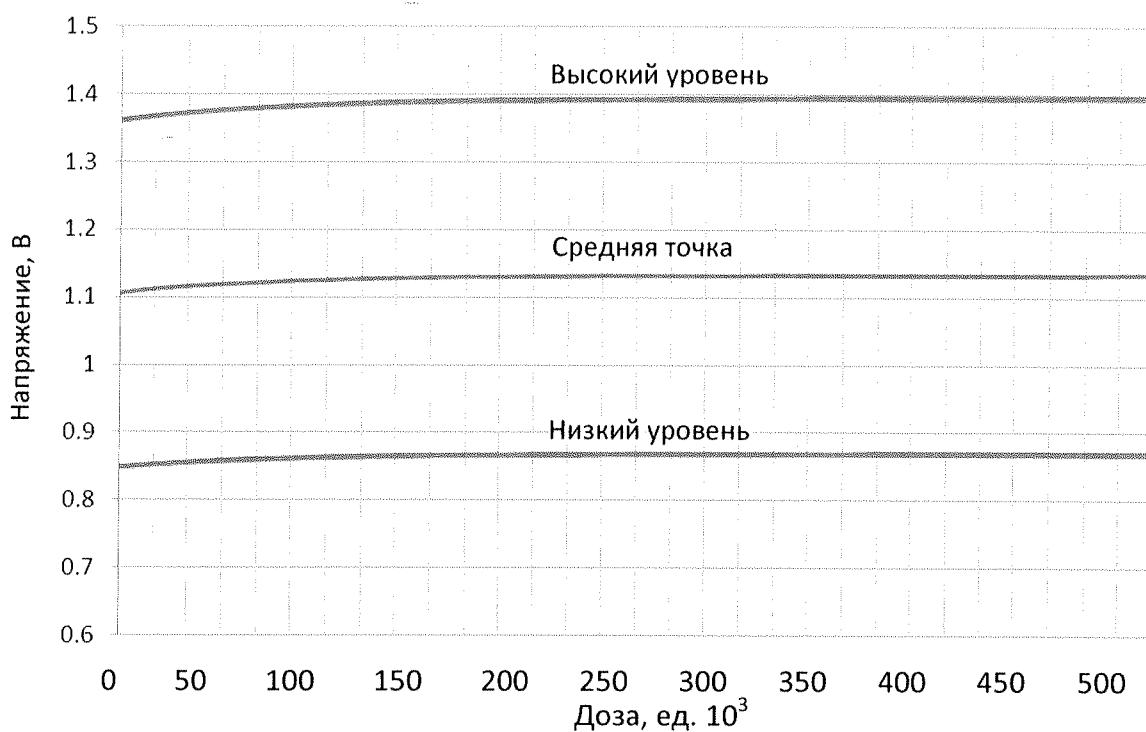


Рисунок 10 – Зависимости уровней выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,0$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1449	Дант. Ильин. О. А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.018Д1	Лист

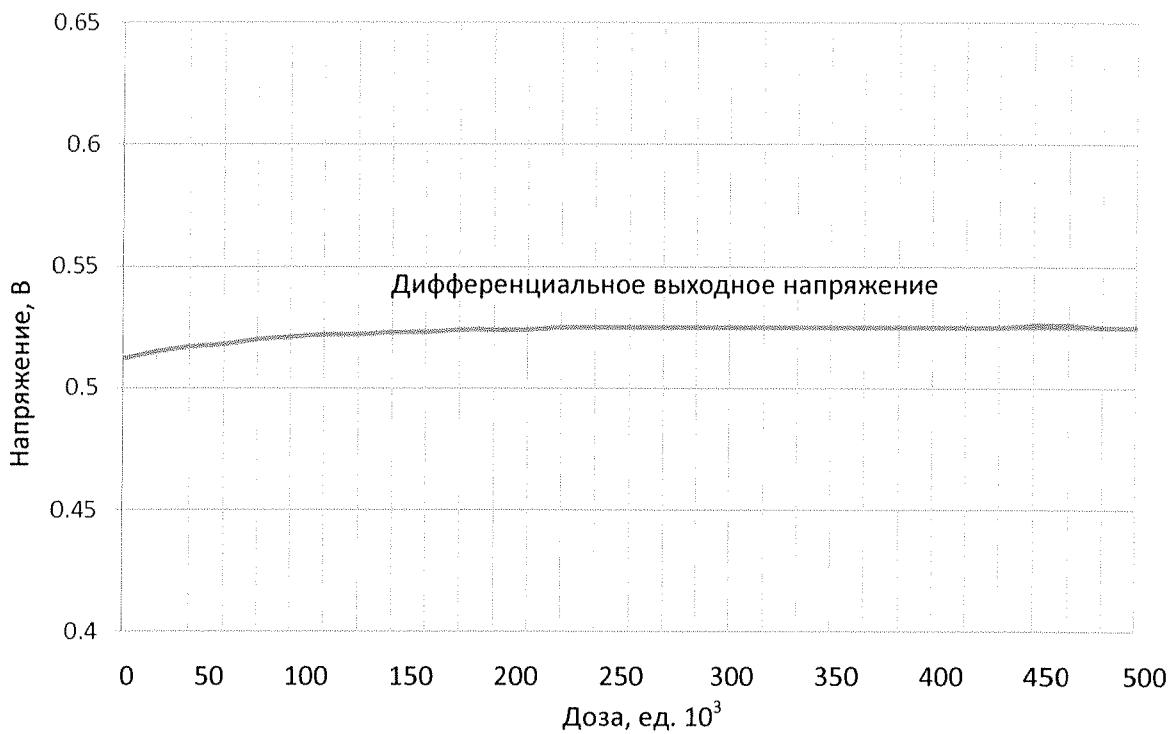


Рисунок 11 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,0$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм. 17	Дж. С. О. №.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАВЛ.431268.018Д1	Лист
						18

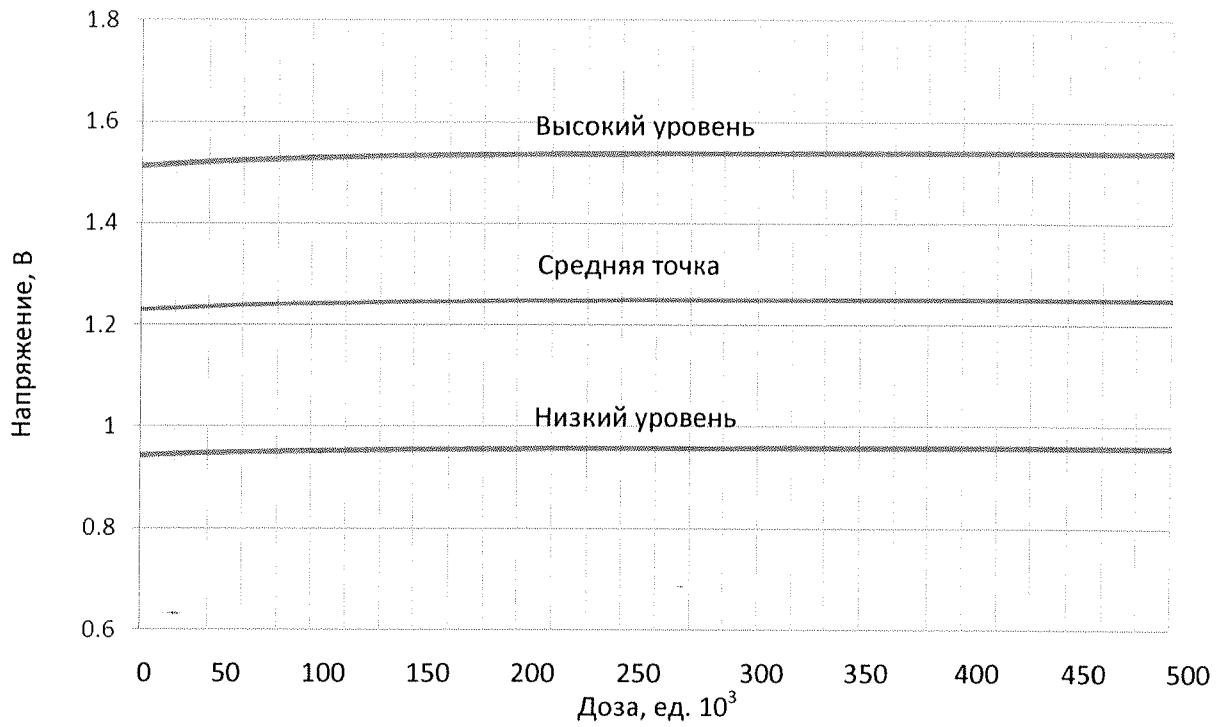


Рисунок 12 – Зависимости уровней выходного сигнала M-LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1291	Дж. Ад. С. 200			

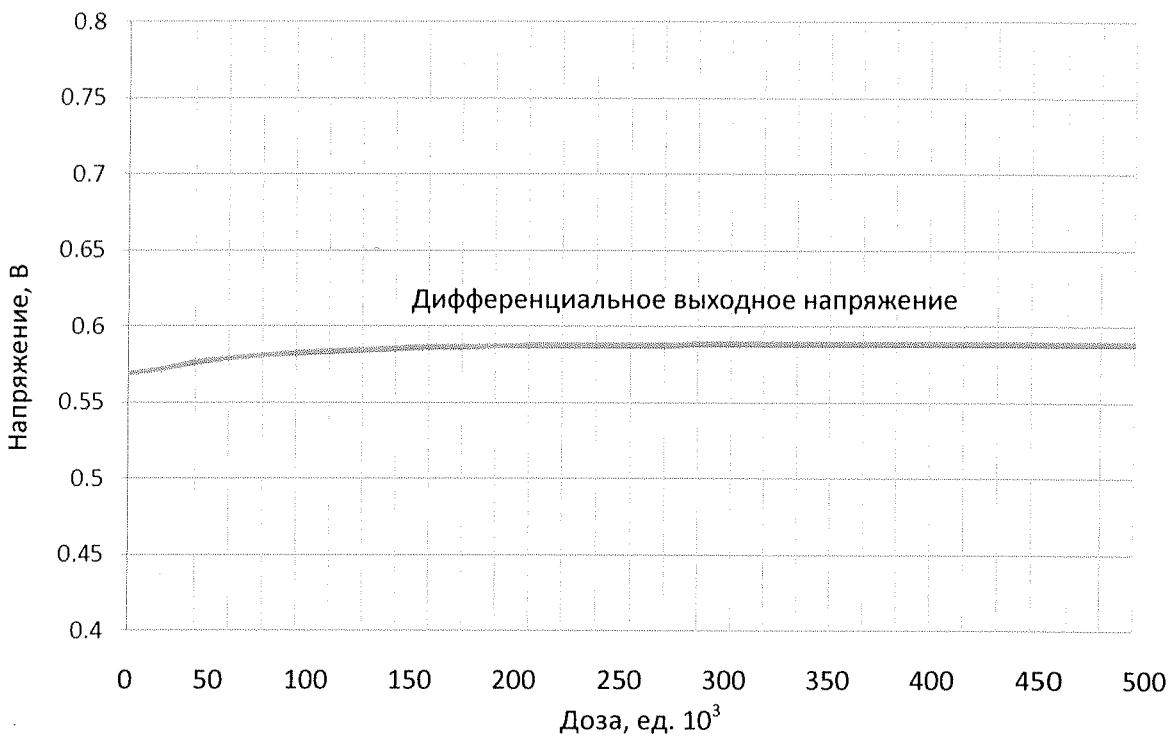


Рисунок 13 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1721	Диф. вх. 01.20.			

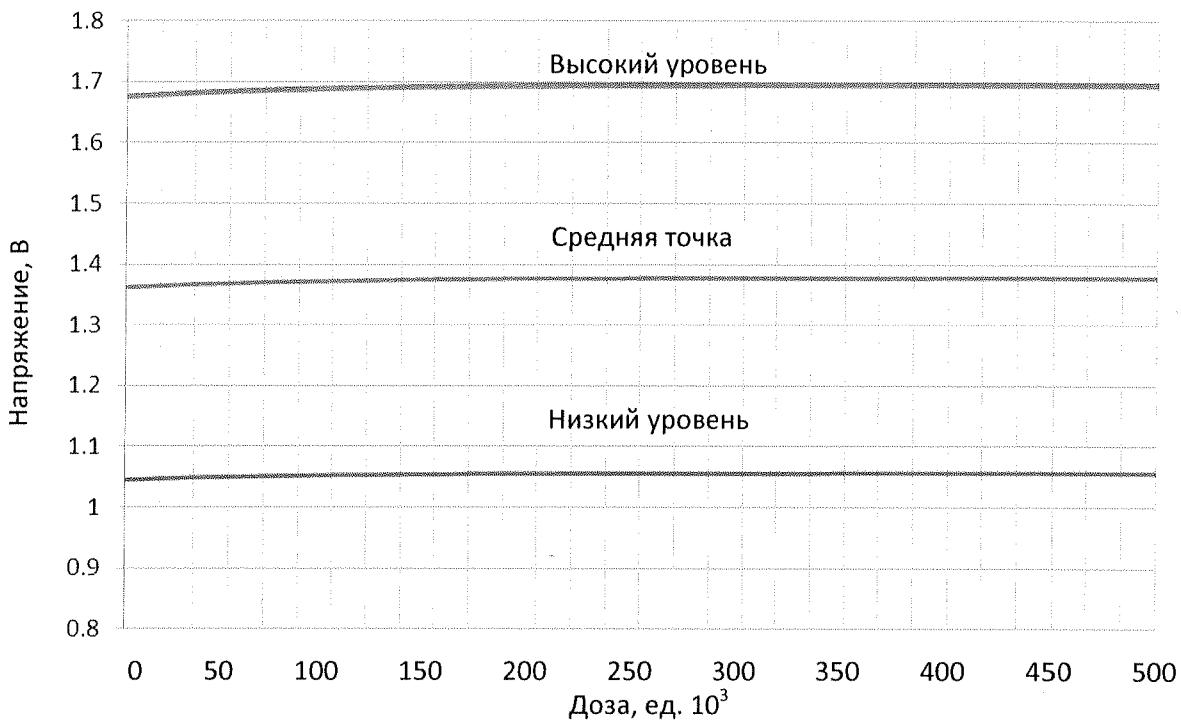


Рисунок 14 – Зависимости уровней выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ 14391	Подп. 22.01.20			

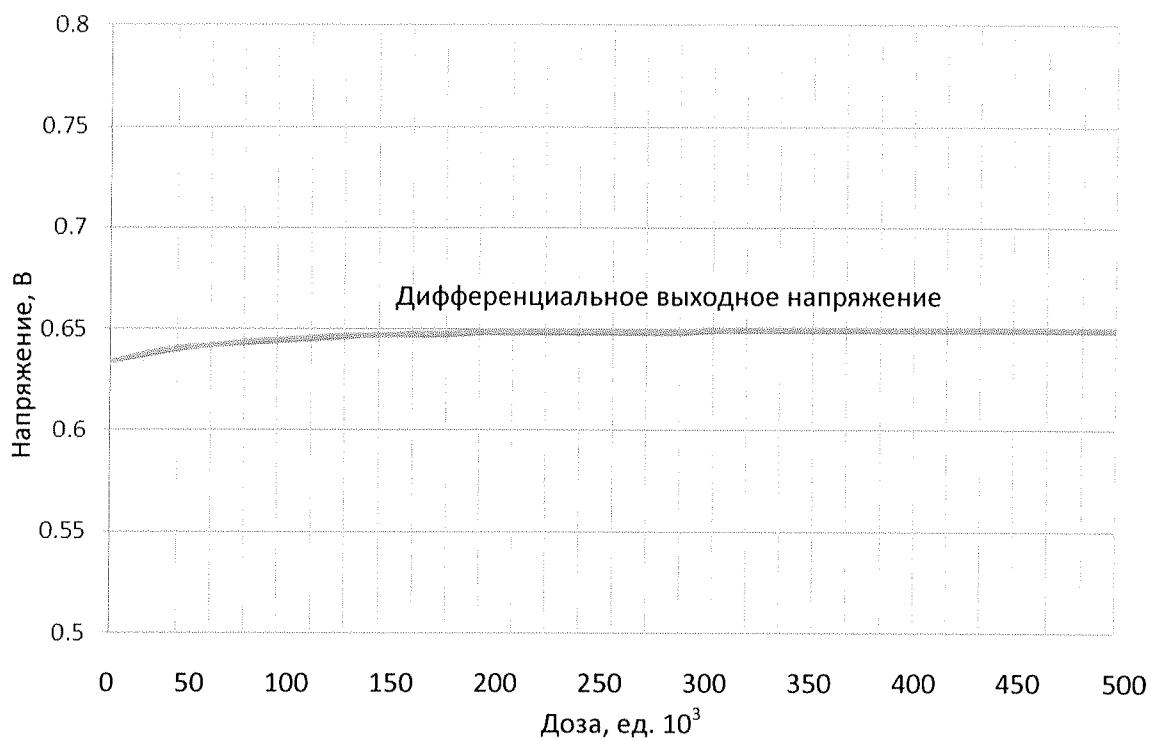


Рисунок 15 – Зависимости дифференциального выходного сигнала М–LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1791	Левин О.Ю.			

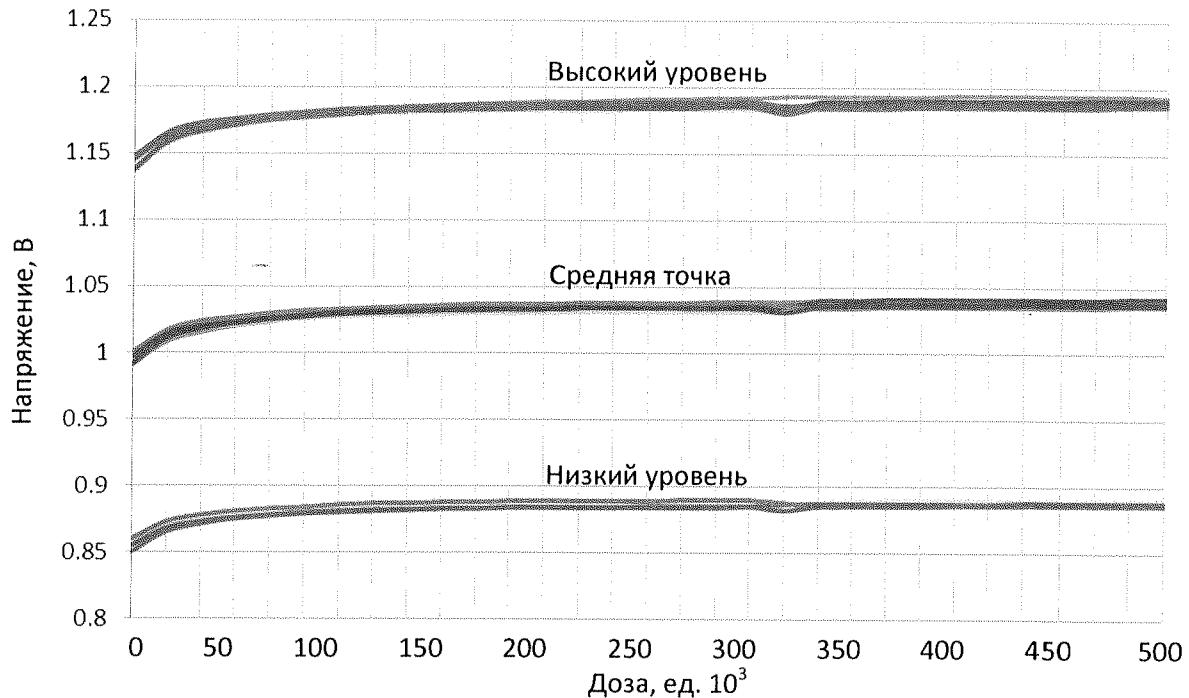


Рисунок 16 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1291	Дж. А. Ст. 06.06.06			

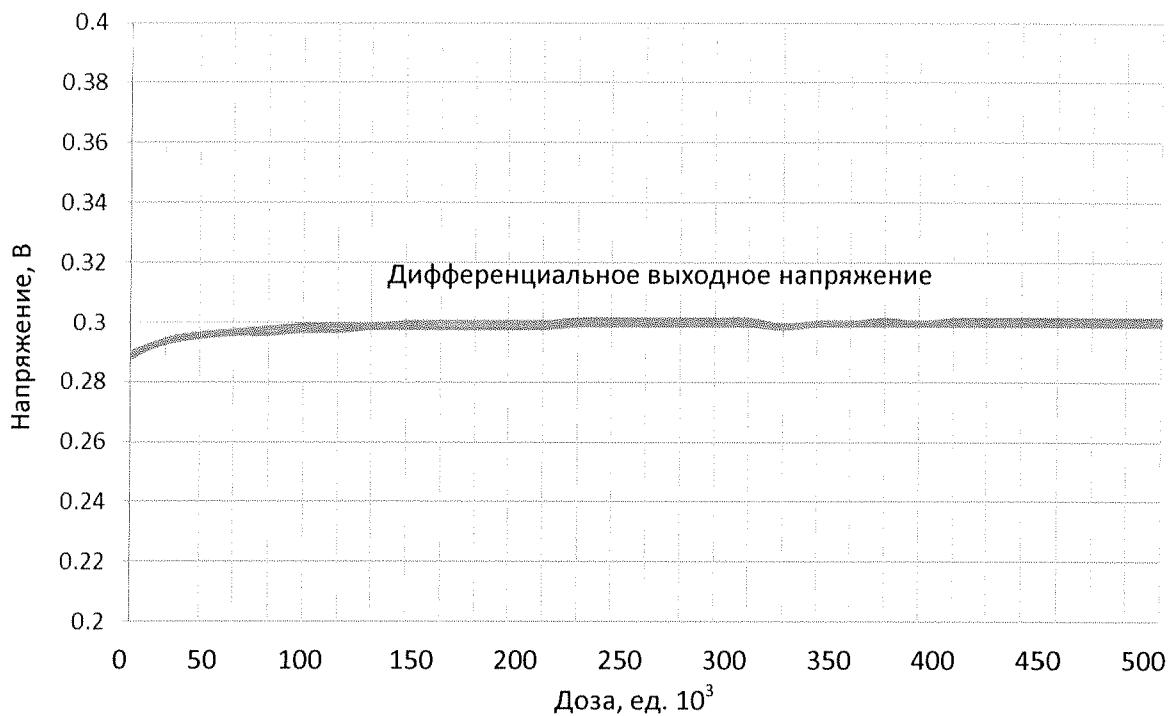


Рисунок 17 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 2,7$ В

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
122/А	Дз. Лх. О. АС			

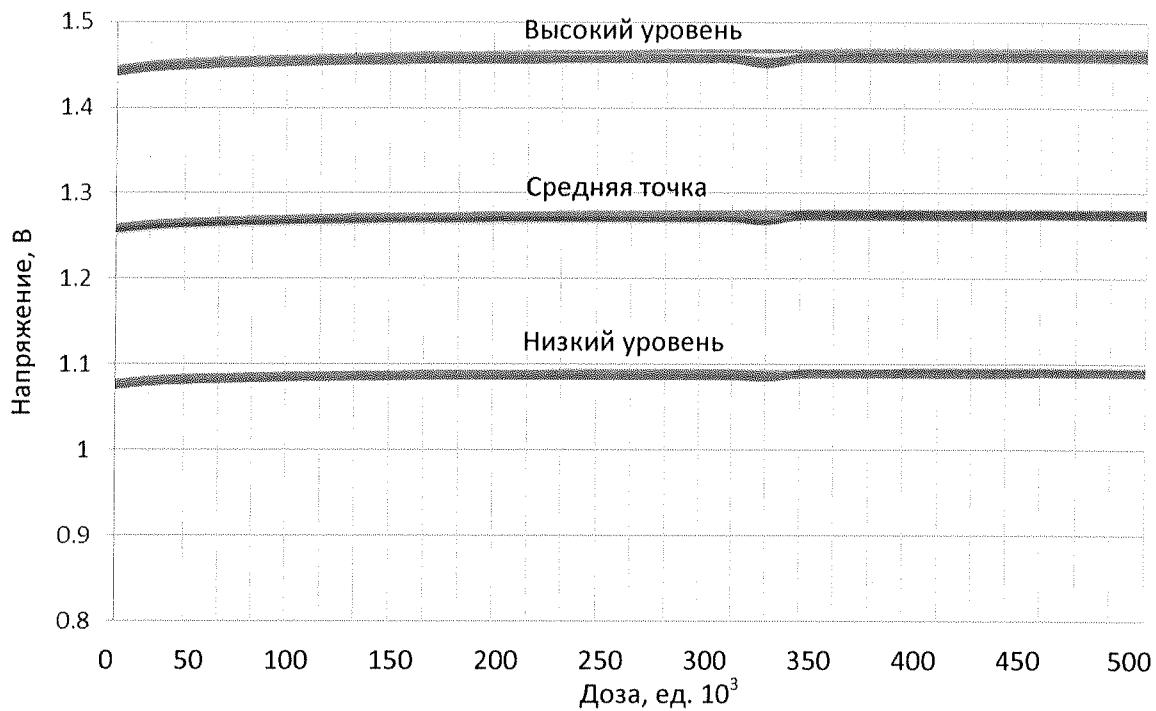


Рисунок 18 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ.431268.018Д1	Листв. А.А.			

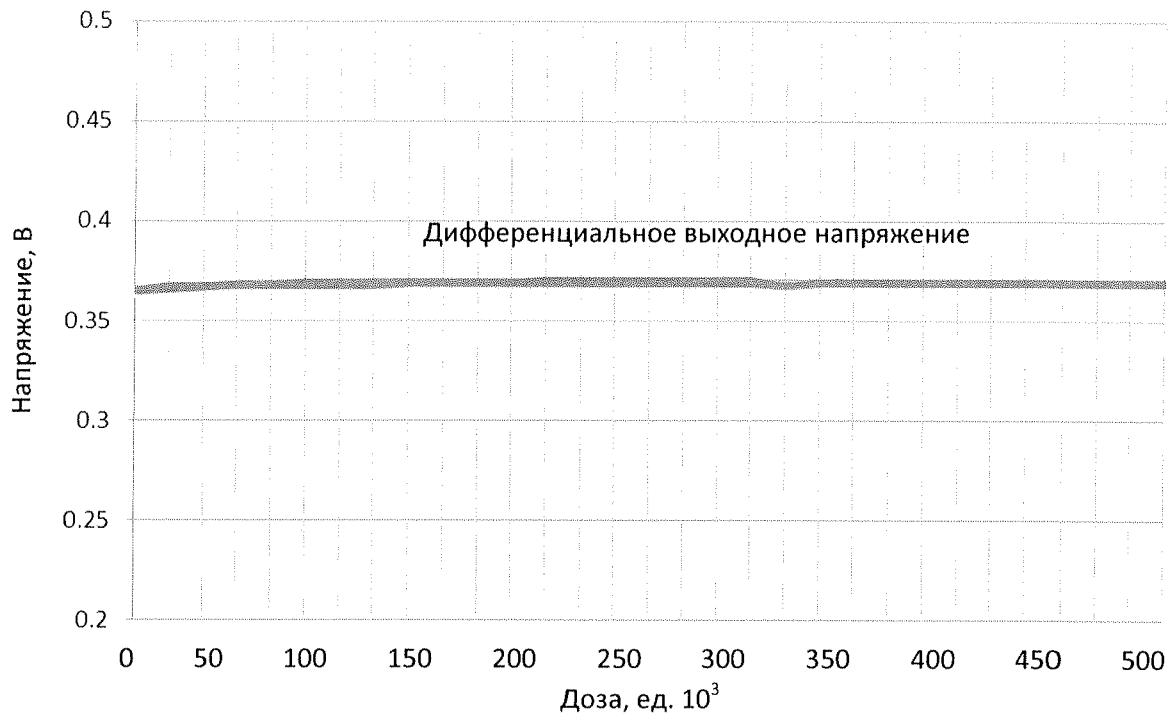


Рисунок 19 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,3$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ГАВЛ.431268.018Д1	Жуков Ю.А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

26

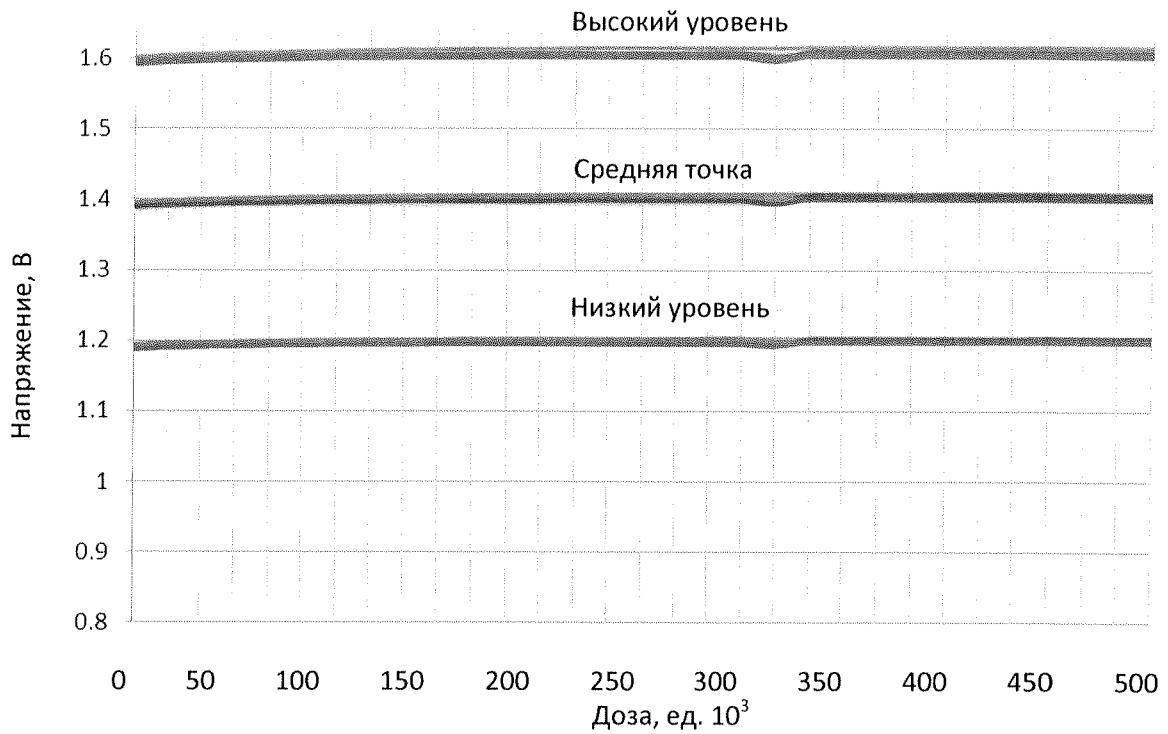


Рисунок 20 – Зависимости уровней выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1791	Дж. А. О. №			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

27

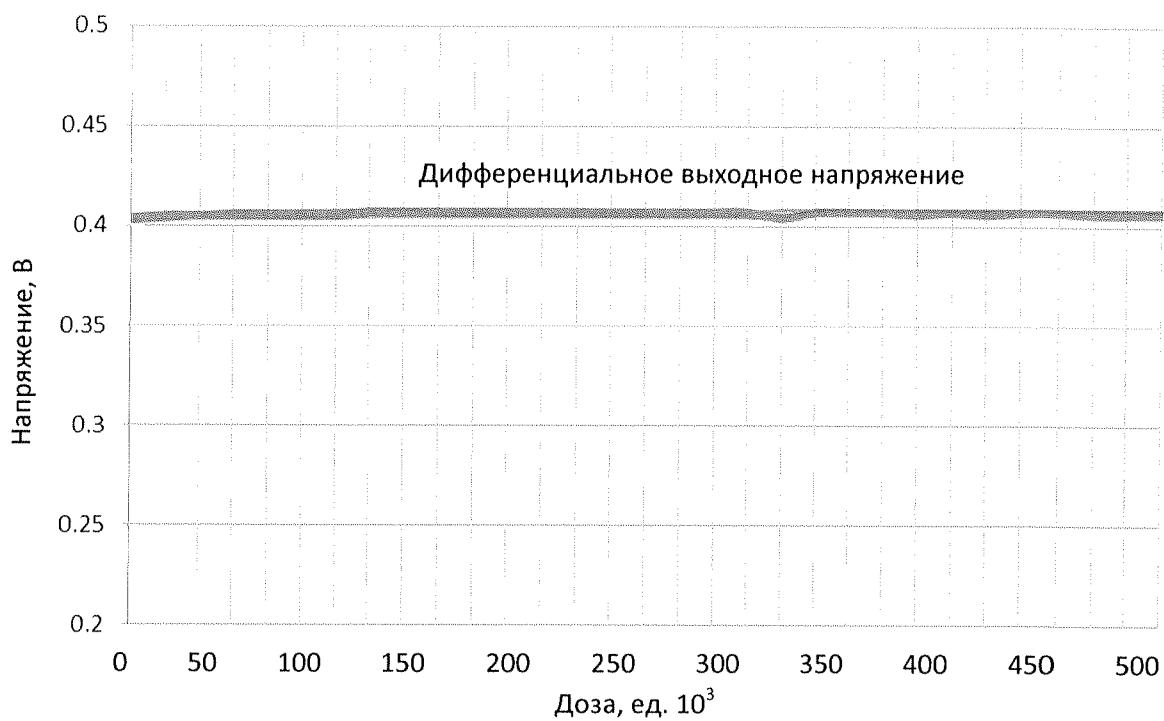


Рисунок 21 – Зависимости дифференциального выходного сигнала LVDS от накопленной дозы при $V_{CC} = 3,63$ В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1391	Лит. О. А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

28

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
12291	Дел. отд. С.Ю.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГАВЛ.431268.018Д1

Лист

29